

2024年日本电子精密仪器加工展/电子智能产品展

产品名称	2024年日本电子精密仪器加工展/电子智能产品展
公司名称	苏州京成展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本展会:2024
公司地址	苏州市花桥镇绿地杰作大厦9号楼1911室
联系电话	18913292209 18913292209

产品详情

2024NEPCON JAPAN日本电子科技博览会

【基本信息】

展会时间：2024年01月24-26日；东京Big Sight 展览馆

展会时间：2024年09月04-06日：东京千叶幕张展览馆

展会时间：2024年10月23-25日：名古屋展馆

展会规模：约1200家参展商；

参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

展会介绍

亚洲领先电子研发，制造与封装技术展会，作为“电子研发，制造与封装技术”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个展会组成。是名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”醉新技术的绝佳场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

市场介绍

日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居市届前列。此外，以动漫产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界典范，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。在返个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业打入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

构成展会

NEPCON JAPAN日本电子科技博览会由六大展会组成：

1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN

汇集了各种电子产品制造及SMT所用设备、解决方案、技术及服务。

2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：

亚洲领先的电子研发制造领域有关测试，检查，测量和分析技术的展会。

3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP

亚洲领先的集成电路制造展！汇集了各种先进的设备、材料及服务。

4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO

亚洲领先！汇集各种电子元件和材料

5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo

装配设备、保证材料/组件、IC封装汇集了如PCB材料，设计开发委托服务与设计工具软件等各种PCBs/PWBs及技术。

6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

电子制造领域精密加工技术专门展！诸如模具制造、切削、冲压加工、蚀刻等各种精密·微细加工技术汇聚一堂！

展览范围

电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、

分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging Technology EXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

电子元件及材料展 ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

印刷电路展 PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO: 冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

电子元器件分为元件和器件，器件包括各类半导体产品，元件包括电容，电阻，电感，变压器等。在被动元件中，RCL(电容，电阻，电感)三大类占了将近90%，而被动三大件中又以电容的产值高，当前应有广泛的电容是MLCC。而在MLCC领域，村田(Murata)高居全球，据相关的数据，村田在全球智能手机用MLCC,saw滤波器以及连接器模组的市场份额分别达到40%和50%以上，村田还是世界大的电感生产厂商。京瓷是日本经营之神稻盛和夫创办的企业，也是世界大的精密陶瓷零部件生产企业，能提供200多种陶瓷材料，主要产品包括如MLCC，各类陶瓷封装，陶瓷基板等。TDK则是磁性材料提供商，早年在录音机时代，TDK生产的磁带曾经。如今TDK在磁性材料，MLCC领域拥有很大的市场份额。